

期刊信息

篇名	电流电弧作用下触头热过程的数值计算
语种	中文
撰写或编译	撰写
作者	吴细秀,狄美华,李震彪
第一作者单位	华中科技大学
刊物名称	华中科技大学学报
页面	2003, 第2期
出版日期	2003年 2月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	材料组分对电触头表面劣化的影响机理